

2016年度 第2四半期

# 決算説明会資料

2016年11月16日



株式会社 メイコー

(証券コード:6787)

## 注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なる場合がございます。

**1**

**2016年度 上半期実績**

**2**

**2016年度 通期見通し**

**3**

**新商品開発**

# 2016年度上半期 決算ハイライト

## 売上

1. 売上は好調に推移したが、急激な円高の影響で円換算上  
前年比3.4%減の457億円
  - ・ 車載向けは、堅調に推移
  - ・ スマートフォン向けは、大きく伸長

## 利益

1. 営業利益は、前年比20.8億円増の26.6億円（4.6倍）
2. 営業外で経常利益は黒字転換 1.42億円  
上半期為替差損 20億円

## 資金

1. 利益の増加、フリーキャッシュフローの黒字定着  
有利子負債、前期末より53億円削減

# 2016年度上半期連結業績

(単位：億円)

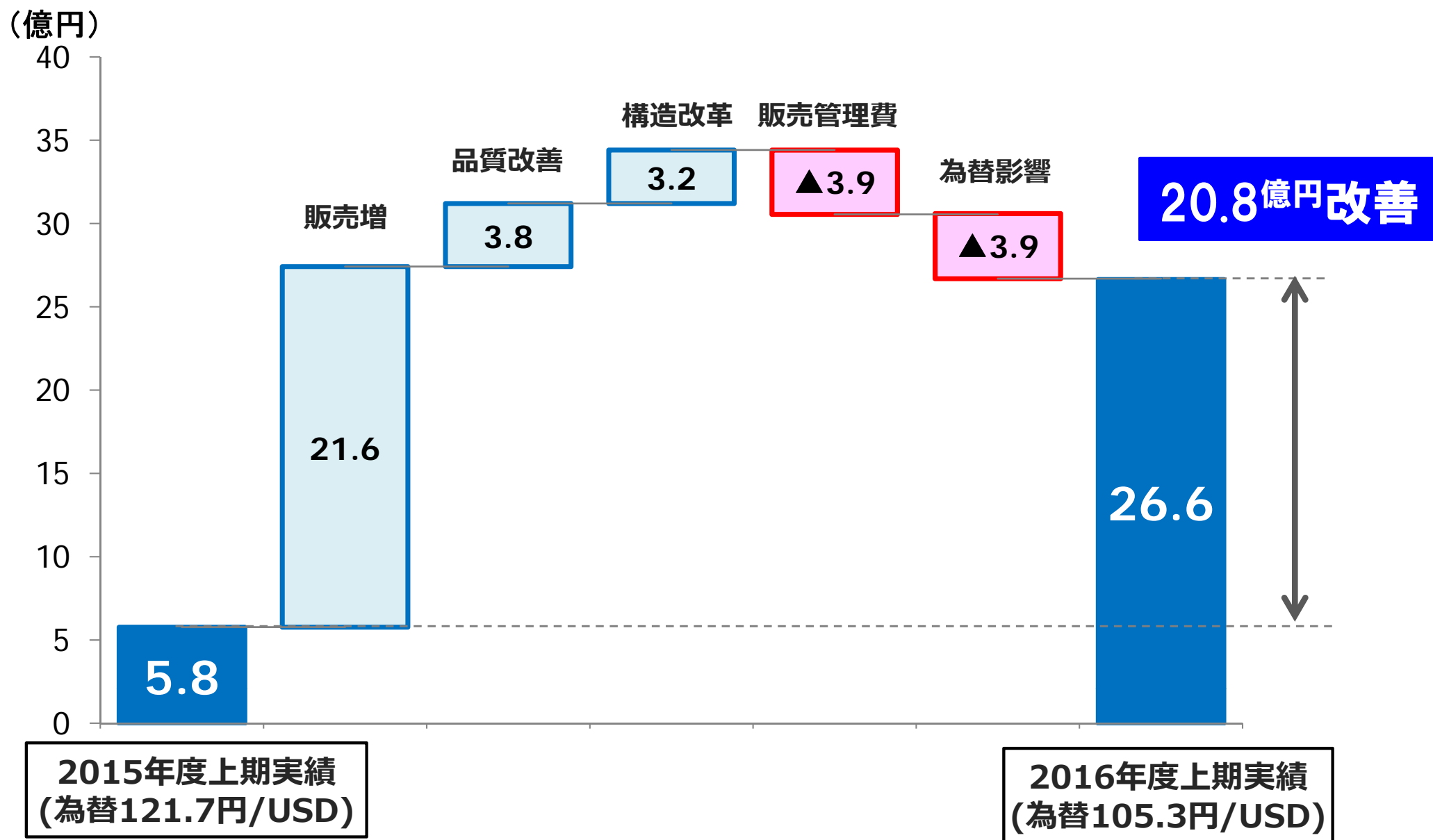
	2015年度 上期 実績	2016年度 上期 実績	前年同期比	
			増減金額	増減率
売上高	473.5	457.4	▲16.1	▲3.4%
営業利益 (利益率)	5.8 (1.2%)	26.6 (5.8%)	20.8	4.6倍
経常利益 (利益率)	▲3.1 (▲0.7%)	1.4 (0.3%)	4.5	—
当期純利益 (利益率)	▲100.5 (▲21.2%)	▲3.8 (▲0.8%)	96.7	—
期中平均為替レート (円/USD)	121.7	105.3		

# 2016年度上半期 海外工場実績

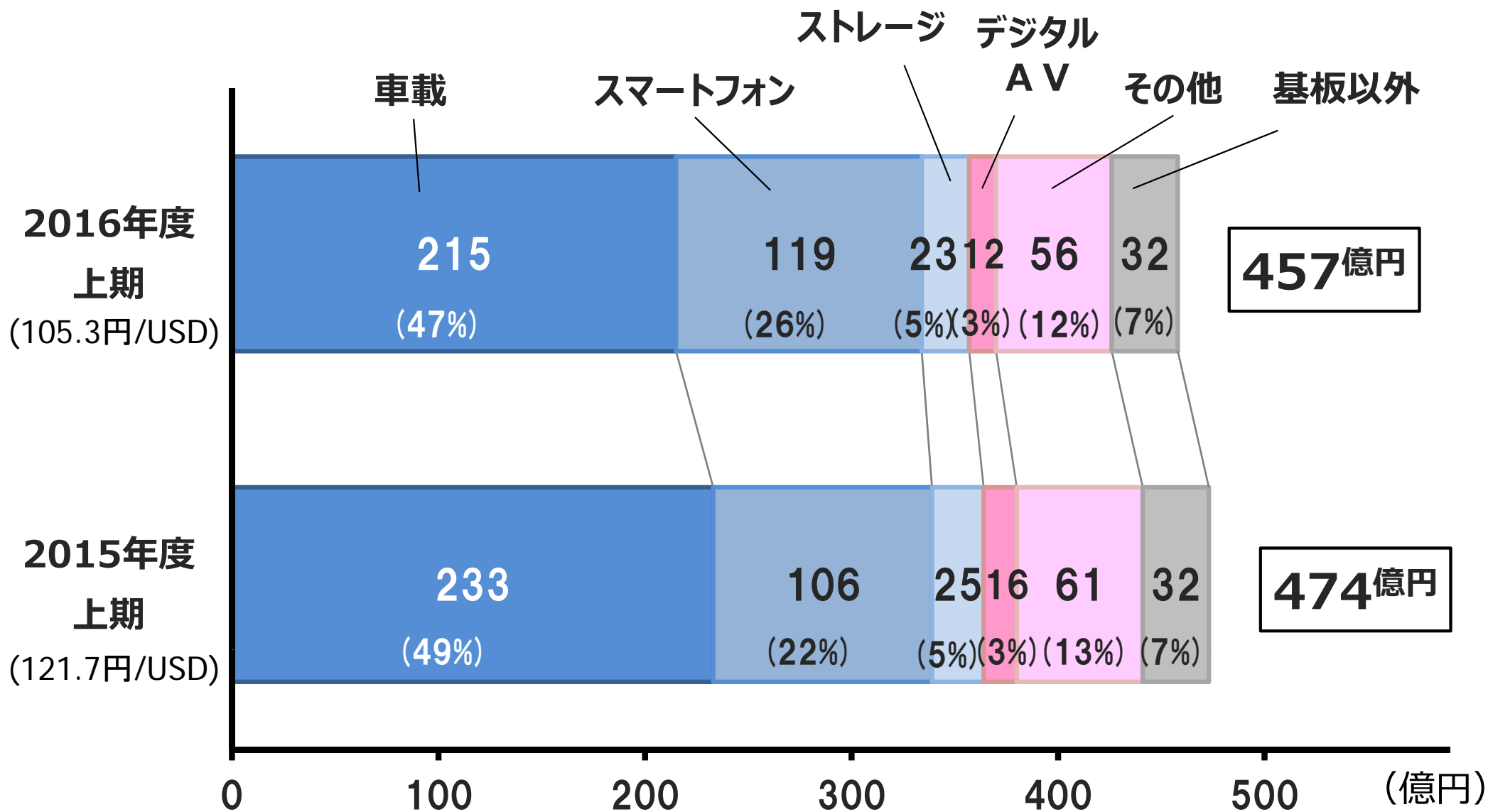
(単位：億円)

		2015年度 上期 実績	2016年度 上期 実績	前年比 増減金額
広州工場	売上高	166.7	132.1	▲34.6
	営業利益 (利益率)	7.3 (4.4%)	8.0 (6.1%)	+0.7
武漢工場	売上高	163.0	180.3	+17.3
	営業利益 (利益率)	1.2 (0.7%)	10.3 (5.8%)	+9.1
越南工場 (タクトット・タンロン 連結)	売上高	68.5	87.3	+18.8
	営業利益 (利益率)	▲0.8 (▲1.2%)	7.4 (8.5%)	+8.2

# 營業利益增減分析 ~ 前年同期比

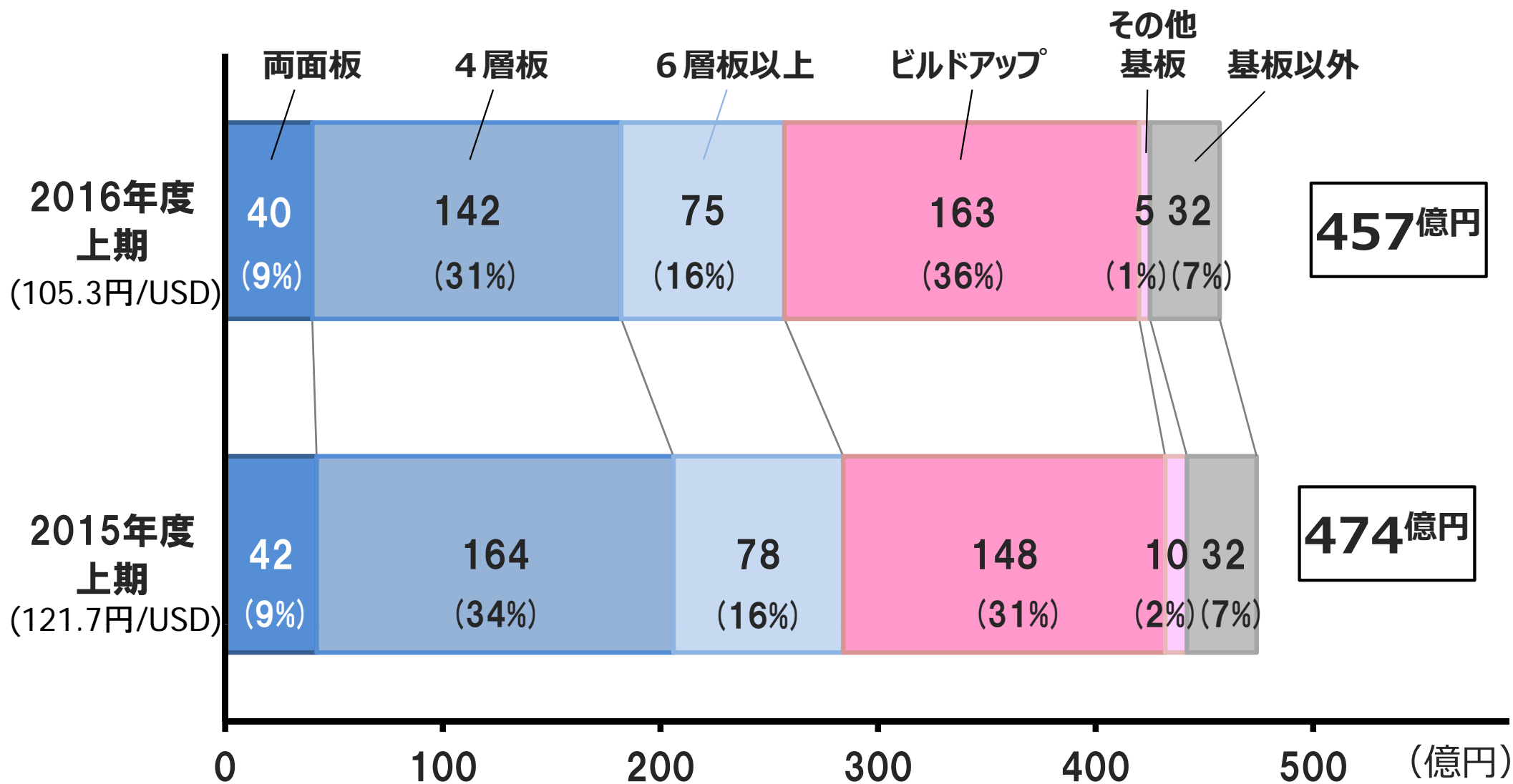


# 販売実績 ～ 基板用途別





# 販売実績 ～ 基板仕様別



1

2016年度 上半期実績

2

2016年度 通期見通し

3

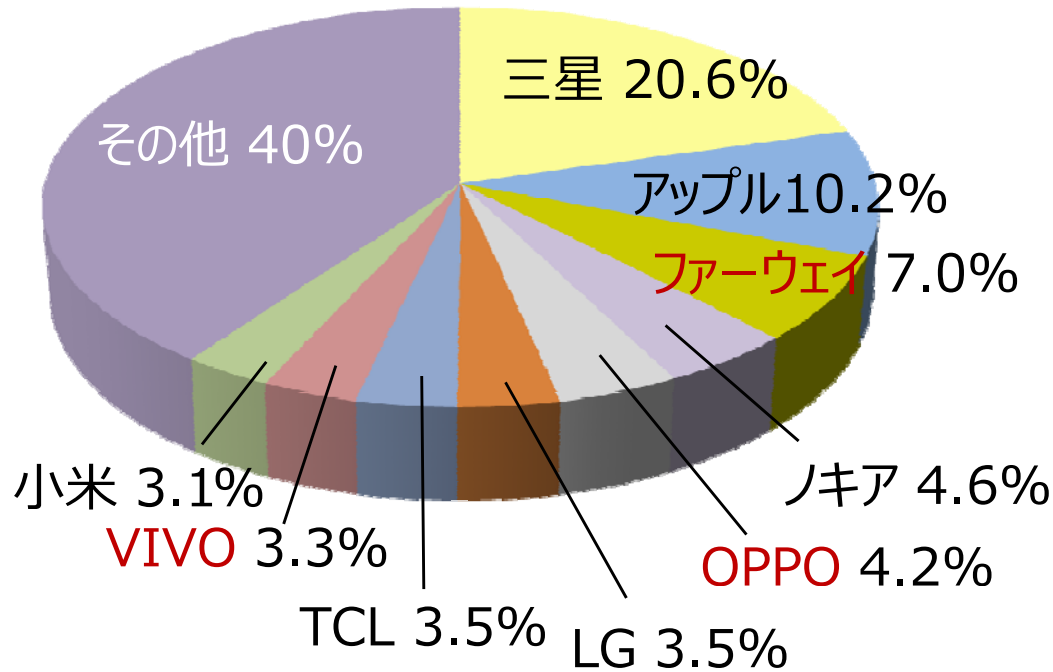
新商品開発

- スマホ市場は、グローバル2強に加え、中国市場において中華系メーカーの台頭
- 自動車市場は、既存市場の堅調な成長に加え安全走行、自動運転 等に向けた新技術の立ち上がり

# スマートフォン市場は安定成長へ

## スマートフォン市場シェア

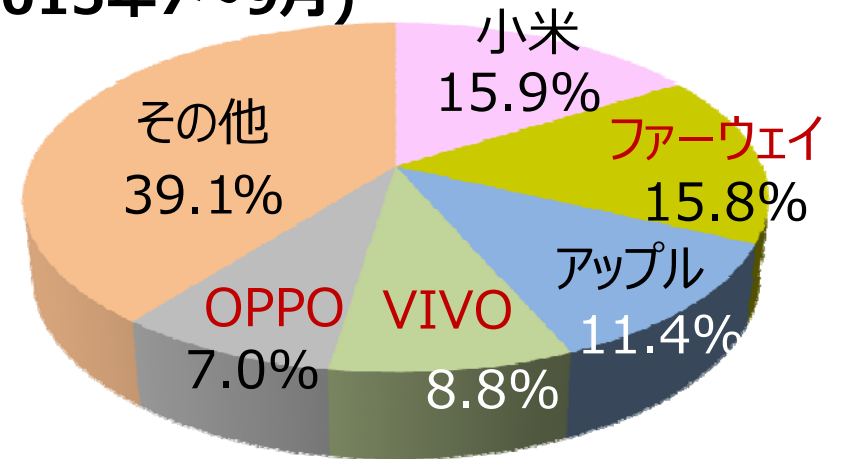
世界市場 (2016年度上期)



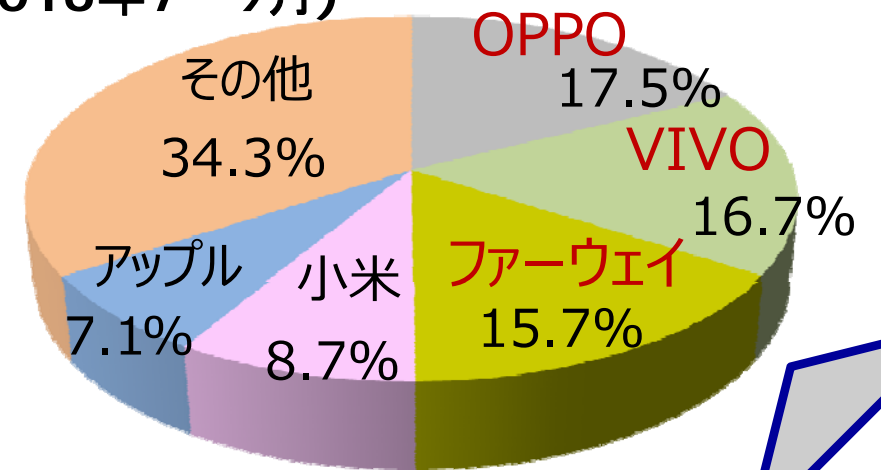
(出典：IDC・EMデータ)

中国市場

(2015年7~9月)

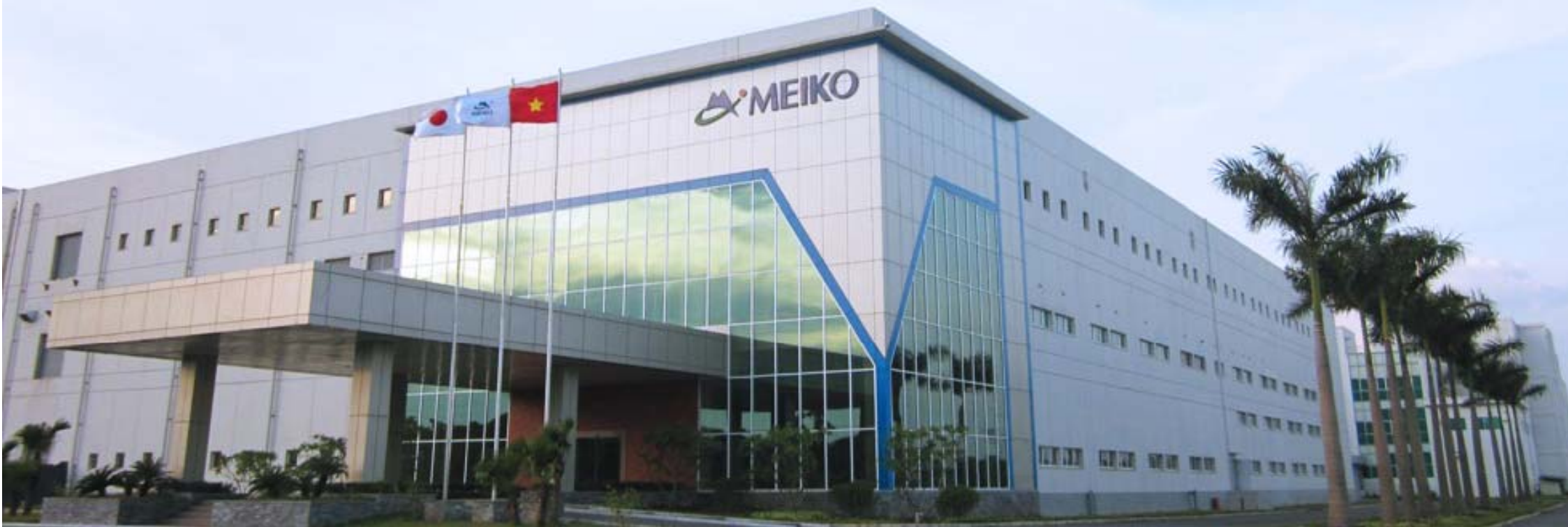


(2016年7~9月)



## ベトナム工場の生産能力増強

- スマートフォン向け基板ライン
- 車載向け基板ライン
- FPC、EMS強化

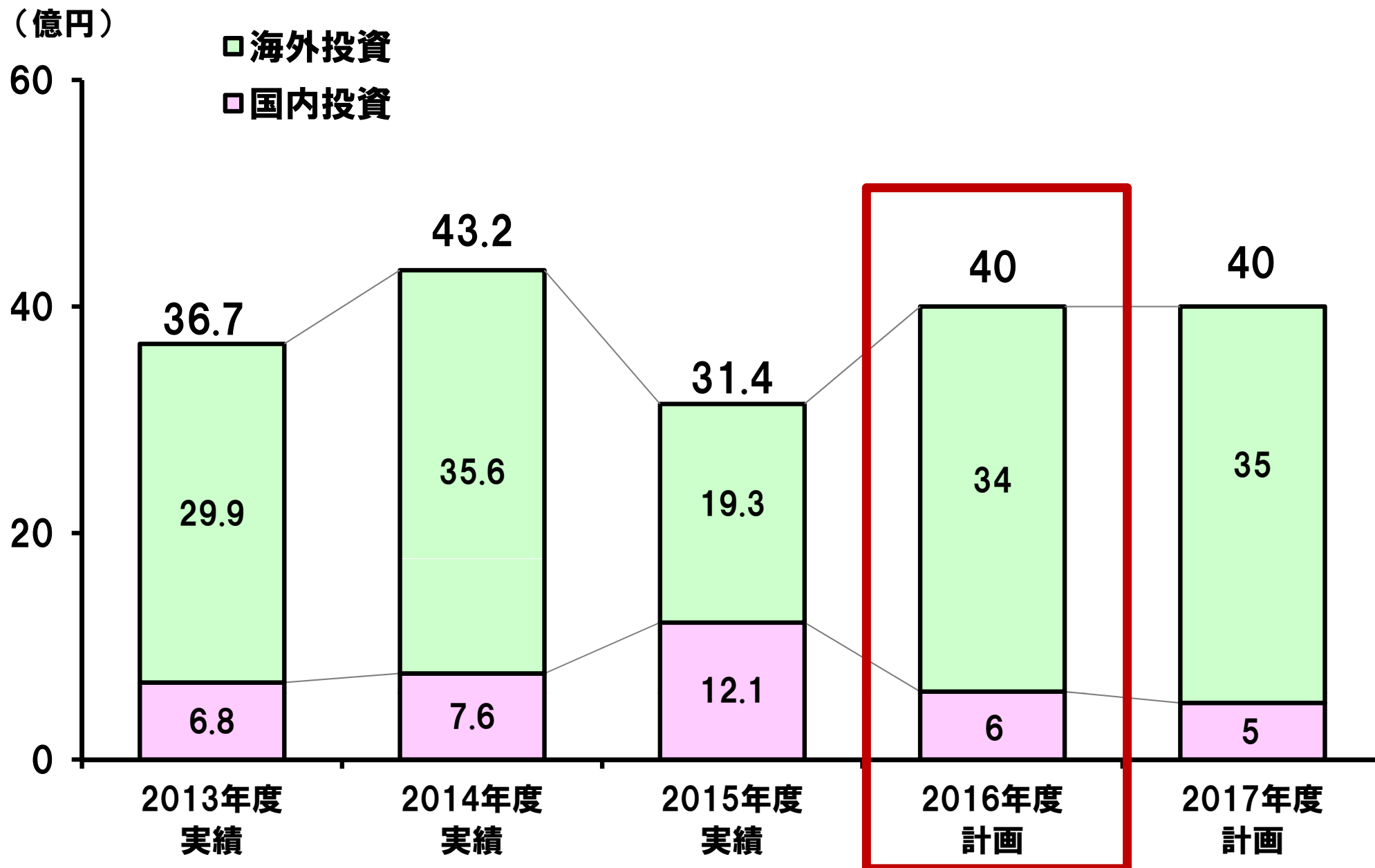


# 2016年度（通期）連結業績見込

(単位：億円)

	2015年度 実績	2016年度			前年比
		上期実績	下期見込	通期見込	
売上高	952.8	457.4	454.6	912.0	▲4.3%
営業利益 (利益率)	33.3 (3.5%)	26.6 (5.8%)	17.4 (3.8%)	44.0 (4.8%)	32.1%
経常利益 (利益率)	▲4.9	1.4 (0.3%)	13.6 (3.0%)	15.0 (1.6%)	—
当期純利益 (利益率)	▲112.5	▲3.8 (▲0.8%)	14.8 (3.2%)	11.0 (1.2%)	—
期中平均為替レート (円/USD)	120.1	105.3	100.0	102.6	

# 設備投資計画



# メイコー これまでの振り返りと今後の展望

過去

東日本大震災によりA社製品を生産する宮城工場全滅  
福島工場被災（操業停止3カ月）  
多額の設備投資によりA社案件を武漢工場へ  
⇒ A社失注 業績低迷へ

現在

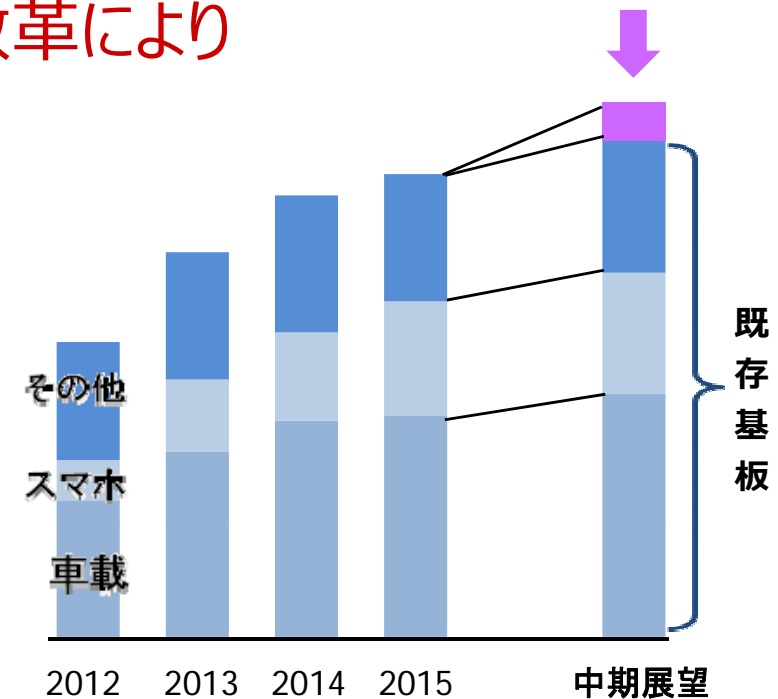
韓国・中華系スマホ受注と構造改革により  
利益体質へ転換

今後の  
展望

車載基板の堅調な成長、  
スマホビジネスの安定拡大

自動運転・IoT・人工知能・  
AR等の新市場が拡大

新規基板・強化学業  
(自動運転、IoT、  
人工知能、AR、  
EMS、フレキ、等)





1

2016年度 上半期実績

2

2016年度 通期見通し

3

新商品開発

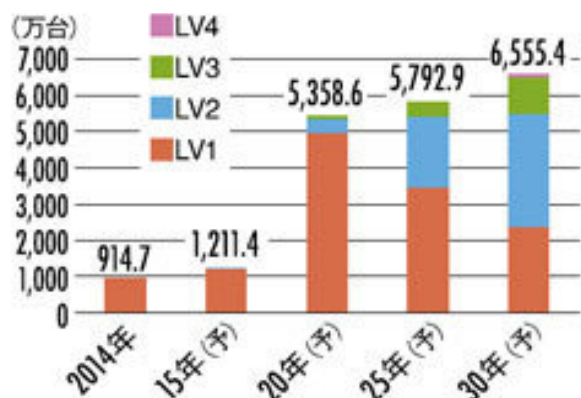
# 自動運転ロードマップ

## ■ 自動運転は今後どう進化？

内閣府SIP参照

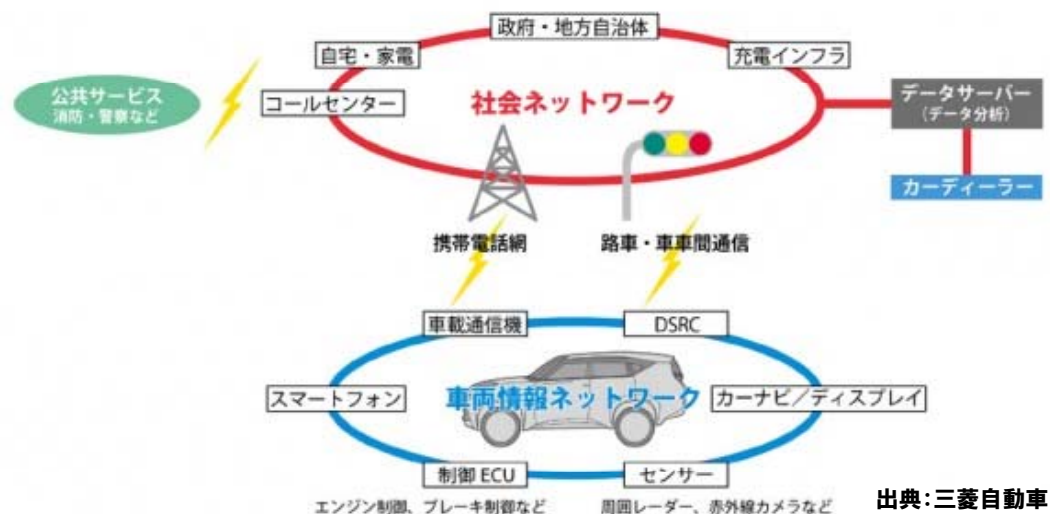
レベル4(完全自動走行) AIが運転 ドライバーが運転に関与しない	2020年代後半
レベル3(準自動走行) AIが運転(ドライバーが監視) ドライバーが緊急時に運転する	2020年代前半
レベル2(準自動走行) AIが加速・操舵・制動を同時に行う ドライバーが主体的に運転する	2017年以降
レベル1(安全運転支援) AIが加速・操舵・制動のいずれかを行う	

自動運転システムの世界市場規模



出所:矢野経済研究所

## ■ 自動運転で何が変わるのか？



コネクテッドカー『つながる車』の普及

全車に通信機能が搭載  
(センシング・通信モジュール市場拡大)

# 自動運転・電気自動車に向けたプリント配線板技術

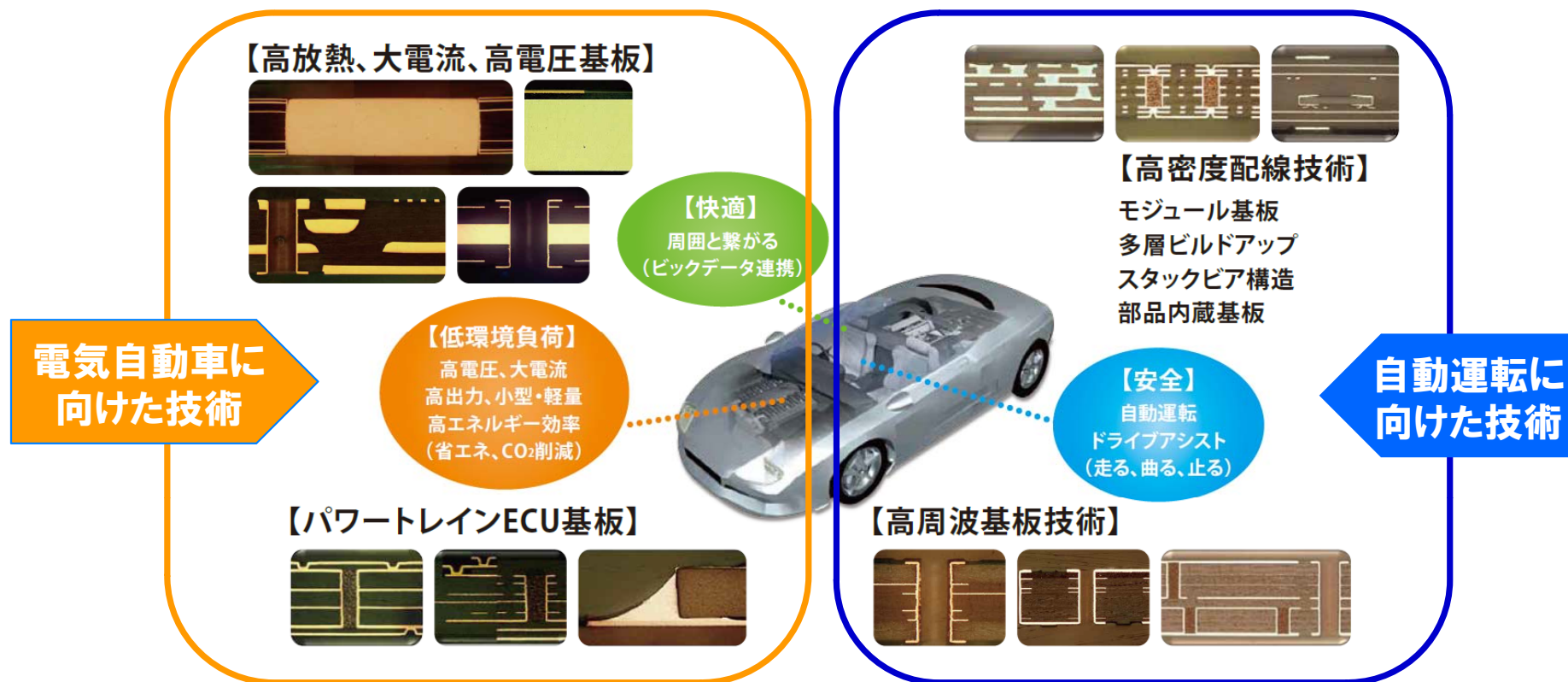
## 自動車用の基板市場規模

	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F
自動車(M台)	84.24	87.39	89.75	90.68	92.50	94.53	97.00	98.80	100.08
基板使用金額(M\$)	4,230	4,680	4,960	5,200	5,500	5,800	6,300	6,600	7,100
基板使用量(\$/台)	50	54	55	57	59	61	65	67	71

出典:N.T. Information Ltd

約8,000億円/2020年

## 自動車に求められるプリント配線板技術



# ADASミリ波レーダー基板(自動運転)

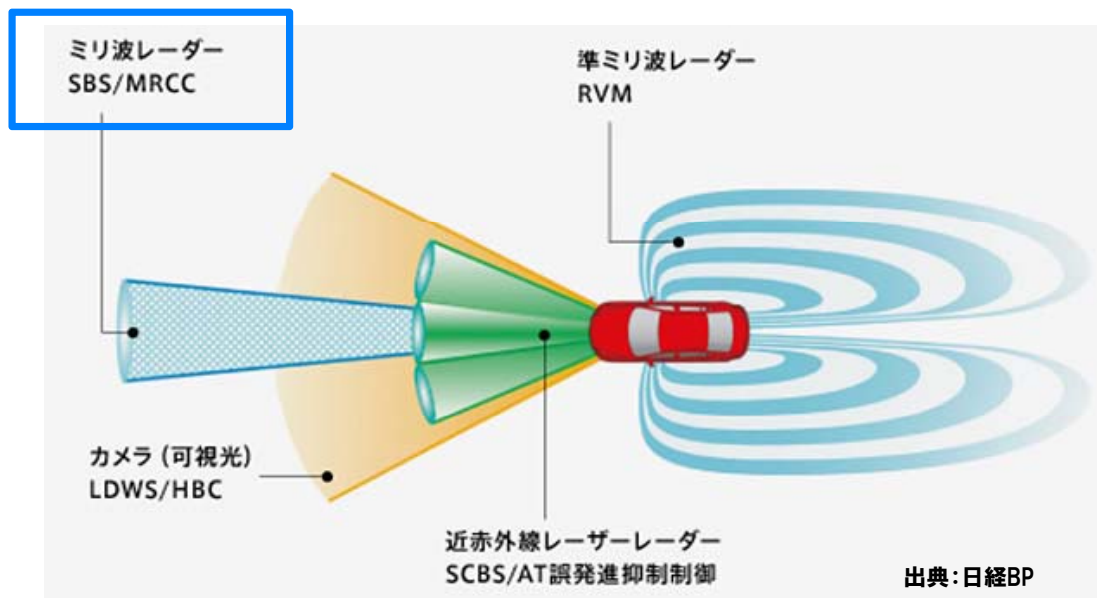
## 用途

自動車用の前方障害物検出センサー、ミリ波レーダー

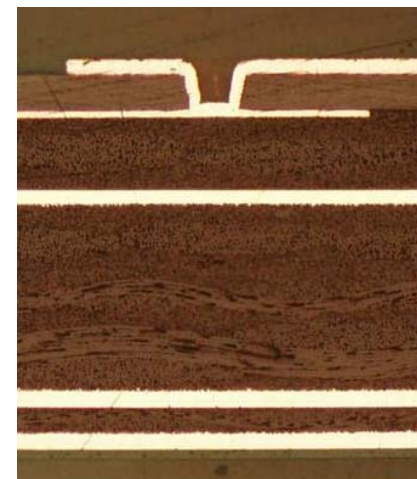
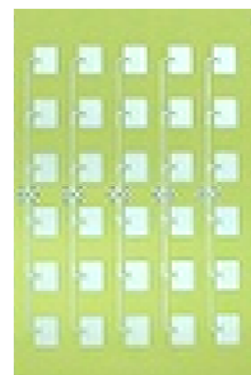
## 特徴

ハイブリッド構造の高周波基板、高性能&組立コスト低減  
～2018年国内工場、海外工場量産予定～

### ■ADASミリ波レーダー



### ■ミリ波レーダー基板(高周波基板)



# ADASカメラ基板(自動運転)

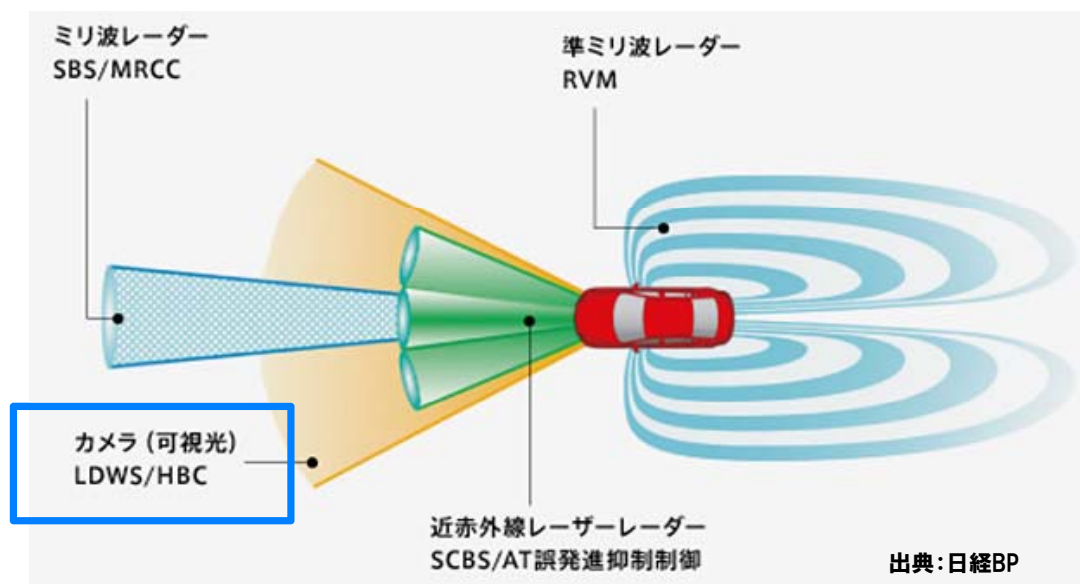
用途

自動車用の外界認識センサー、ADASカメラ

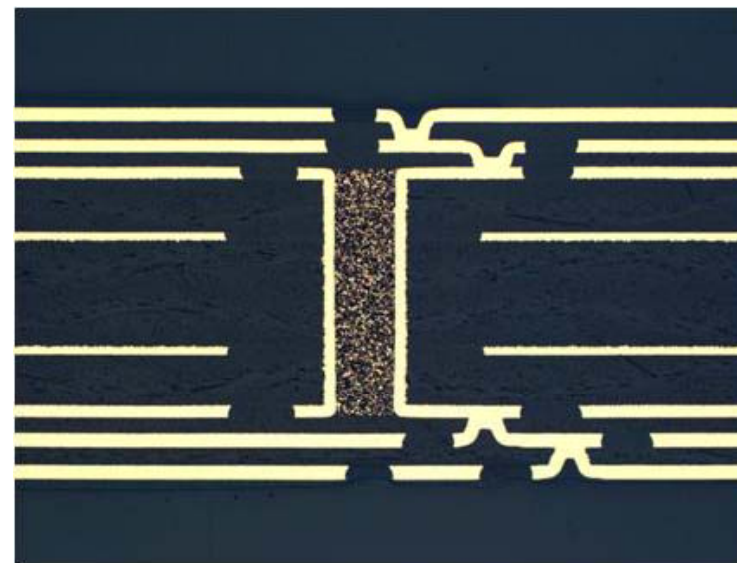
特徴

高密度ビルトアップ基板、小型化&インピーダンスコントロール  
～2013年から量産開始～

## ■ADASカメラ



## ■カメラ基板(高密度ビルトアップ基板)



# 銅インレイ基板(ハイブリッド・電気自動車)

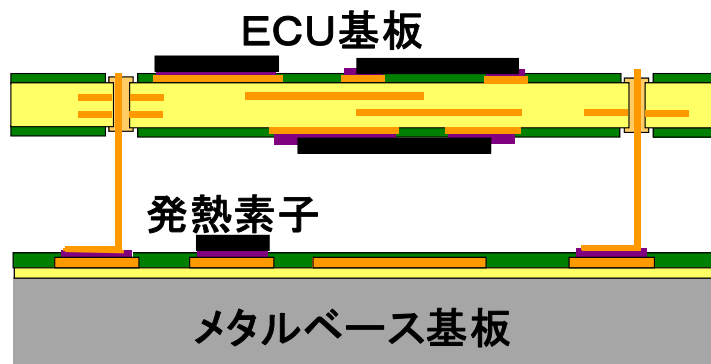
## 用途

自動車用のABS(ブレーキ)、EPS(ステアリング)

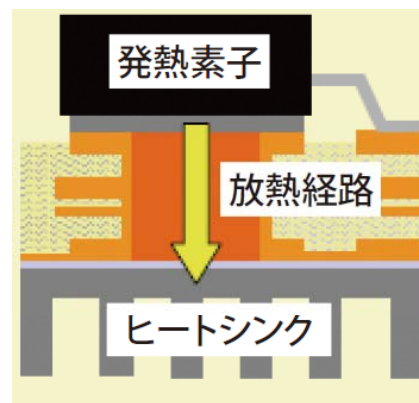
## 特徴

2枚基板構造からECU基板1枚化、小型・軽量化  
～2019年量産予定、顧客3社で採用検討～

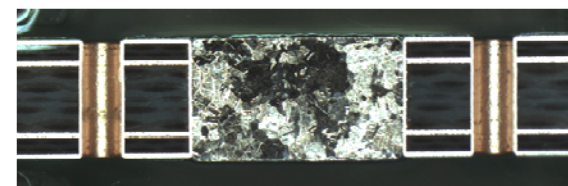
### ■従来構造



### ■新規構造



### ■銅インレイ基板



# パワーIC内蔵基板(ハイブリッド・電気自動車)

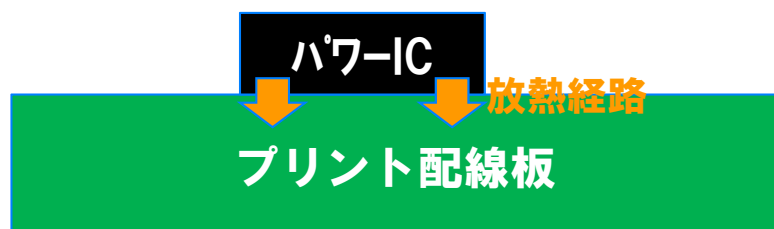
## 用途

自動車用のパワーユニット

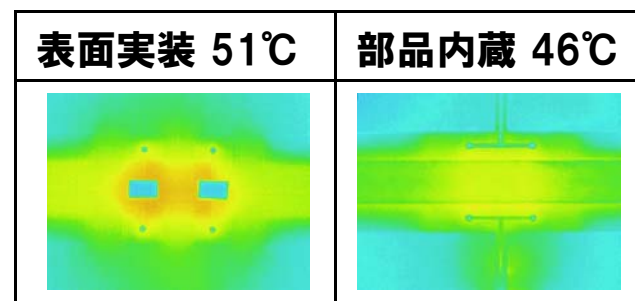
## 特徴

大電流・高放熱の対応、ユニットの小型・軽量化  
～2020年以降量産ターゲット、顧客と共同開発～

### ■従来構造(パワーIC表面実装)



### ■パワーIC放熱効果



### ■新規構造(パワーIC内蔵基板)



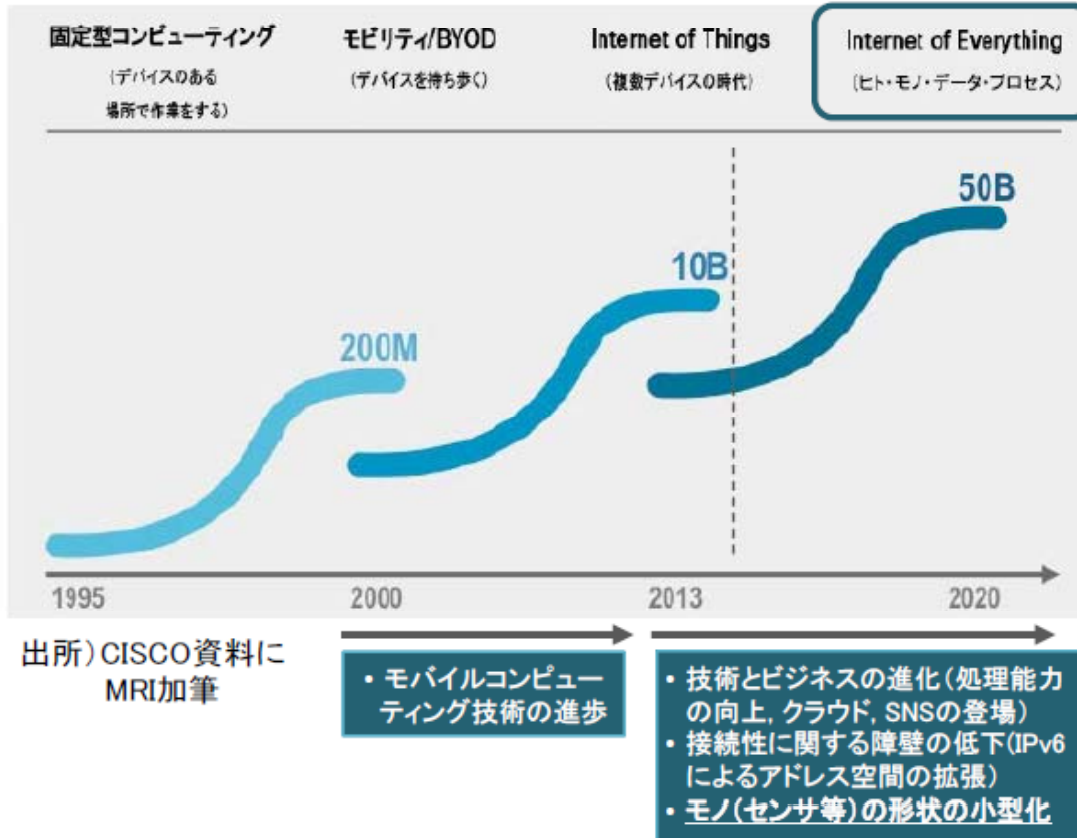
### ■パワーIC内蔵基板断面



# IoT(IoE)が創出する市場規模

## IoTとM2Mの市場規模

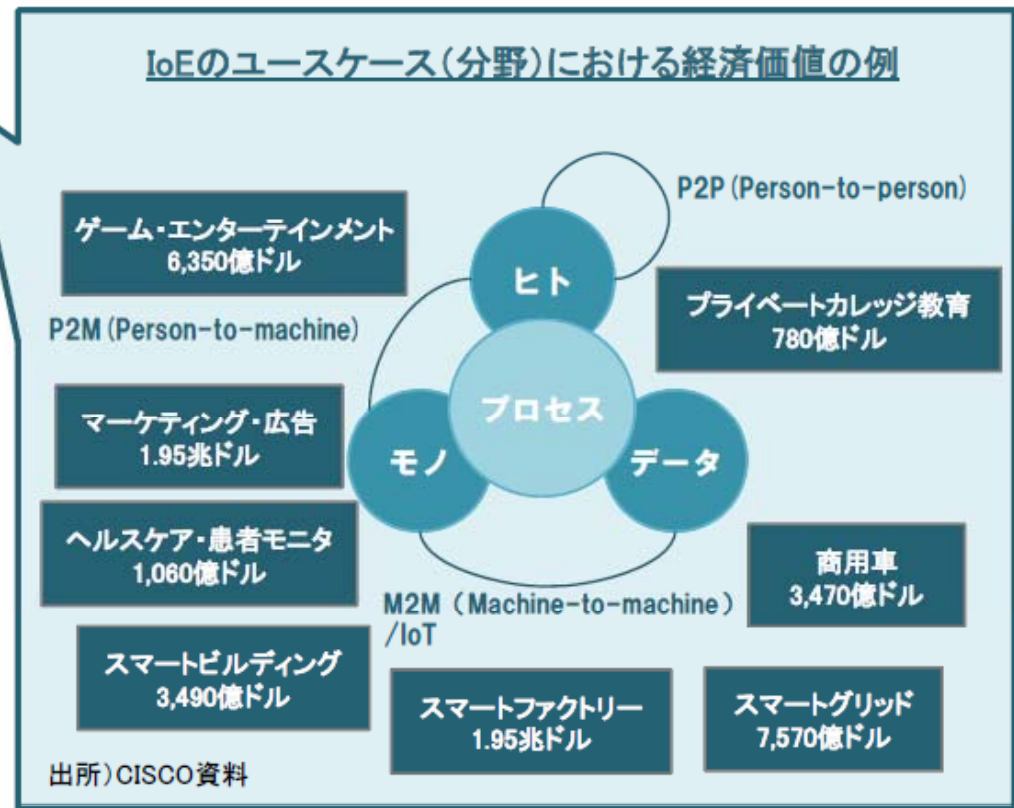
インターネットに接続するモノの数の推移



## 世の中のすべてのモノ 1.5兆個センサの需要

今後10年間でIoEが生み出す経済価値⇒14.4兆ドル

IoEのユースケース(分野)における経済価値の例



※経済価値: 今後 10 年間で Internet of Everything を活用する能力に基づいて創出される、または全世界の企業や業界の間を移転する、潜在的な収益の価値に関する予測。

出典: 三菱総合研究所

IoT/M2Mによりセンサー・モジュール市場の拡大が期待される



# 薄型モジュール基板(IoT)

## 用途

通信モジュール、センサーモジュール

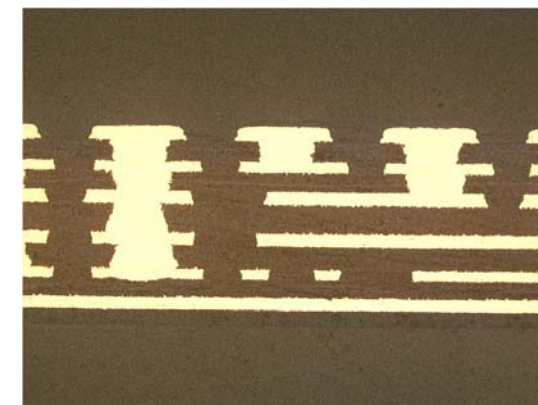
## 特徴

小型・薄型化、高密度実装 & 高密度配線基板  
～ベトナム工場、石巻工場量産～

### ■通信モジュール



### ■薄型モジュール基板 (AnyLayer基板)



# 高密度メイン基板・モジュール基板(IoT、AI、ビッグデータ)

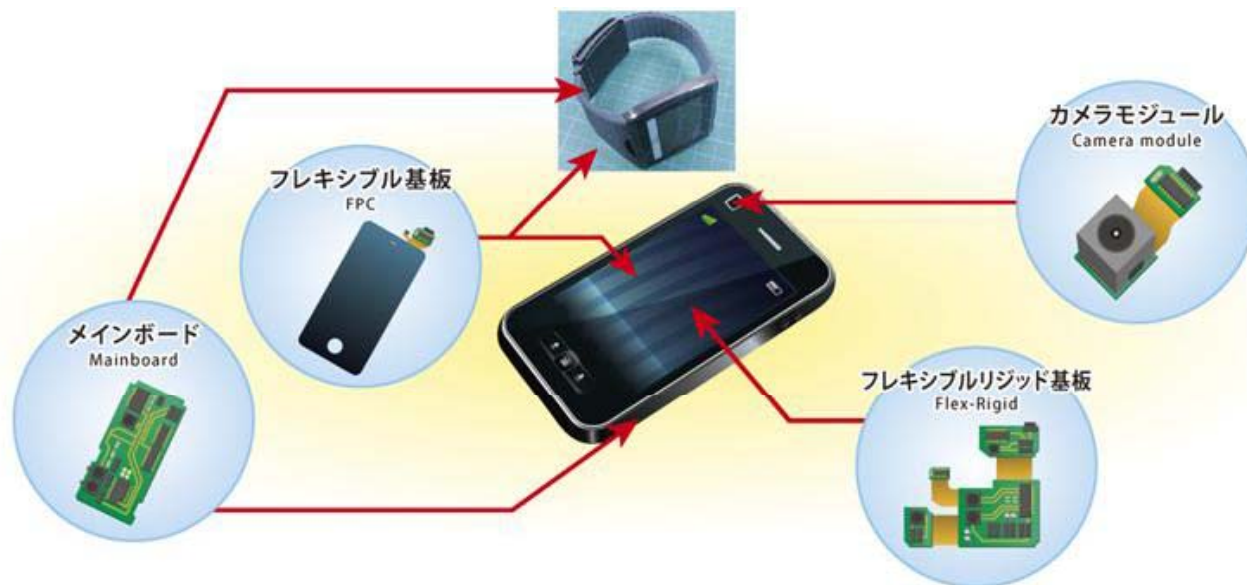
## 用途

様々な通信機器、センサー、デバイス等

## 特徴

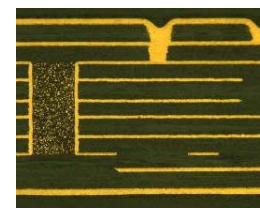
高密度ビルトアップ基板、AnyLayer基板、フレキシブル基板  
～武漢工場、ハトナム工場、石巻工場量産～

### ■スマートフォンを取り巻く様々なプリント配線板

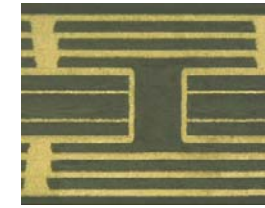


### ■メインボード構造

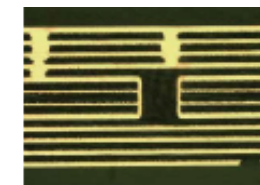
2段ビルトアップ基板



3段ビルトアップ基板



4段ビルトアップ基板



AnyLayer基板





<http://www.meiko-elec.com/>